

# 技術部 技術講習会のお知らせ

## 「ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作」

技術部装置開発グループ

対象 : 工学部4年生および工学研究科大学院生、  
工学研究科教職員

日時 : 講習会受付期間 2012年6月～2012年11月末。  
講習会実施日 2012年7月～2012年12月中旬(随時実施)。  
講習希望者と相談の上、講習日を決定します。  
講習時間 3-4時間程度。

場所 : 第二合同棟 物理工学科 ナノ加工工作室(6106室)

内容 : 

- ・ボール盤作業とねじ切りの基礎知識についての講義。
- ・数種類(軟鋼、ステンレス、アルミ、黄銅)の金属を使用して、ボール盤による穴あけとタップ、ダイスによるネジ切り実習を行います。(ペーパーウエイトの製作を行います。)

受講人数 : 1回 2-4人程度を予定しています。  
先着30名程度(材料の都合のため)

申込方法 : 所属研究室名、氏名、靴のサイズ(安全靴使用のため)を記入の上、下記のアドレスへお送りください。

\*なお、ご質問等、ございましたら、下記のアドレスまたは、電話にてご連絡ください。  
ほかの材料についてのボール盤実習を希望される方がありましたら、ご相談ください。

\*服装は、汚れてもよい、作業に適した服を着用のこと。  
(安全のため、作業に適した服装でないと判断した場合は、お断りすることがあります。)

連絡先 技術部装置開発グループ 村井健一  
[murai@phen.mie-u.ac.jp](mailto:murai@phen.mie-u.ac.jp) 電話 内線 9377

## 技術部 技術講習会(2012年度)

「ボール盤作業とタップ、ダイスによるネジ切りの基本操作」

技術部装置開発グループ  
スタッフ 堀田、小林、堀場、村井



場所 : 第二合同棟 物理工学科 ナノ加工工作室(6106室)